



非破壊・非接触熱構造解析技術【nonTAP法】 Laser Bond Tester

○本社所在地：愛知県岡崎市 針崎1丁目1番地16

○事業概要：電線加工を起点とした電気機器製造、各種装置、検査装置の開発・製造・販売、変圧器等の販売

「Laser Bond Tester (LBT)」事業

○常時使用する従業員：220名

（グループ全体・2025年6月時点）

○現在の売上高：18.2億円

（グループ全体・2025年5月期）

○法人番号：2180301001289

○Web：http://www.takeshiro.co.jp

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
酒井 快弥

竹代は、『八方良し』のバランスを取り、幸せの源泉を提供し続ける企業を目指す。

株式会社竹代は、創業70年の「ものづくり」の知見と、「Laser Bond Tester (LBT)」事業の革新的な「微小金属接合・非破壊熱構造解析技術【nonTAP法】」を融合させます。現在、地政学リスク等により世界の半導体サプライチェーンは「品質と信頼の危機」に直面しています。私たちは、破壊検査では見えない「電気伝導性」を可視化する本技術により、AI半導体やEVバッテリーなど「国家戦略技術」の品質を底支えます。
私たちは、単なる装置メーカーを超え、「世界の品質基準（グローバルスタンダード）を創出する企業」へと変革し、日本の産業競争力強化と、全てのステークホルダーへの「安全と信頼」の提供を宣言します。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

「2028年に売上高100億円達成を目指す」

2028年：グループ売上高 120億円（グローバル量産体制の確立）
2033年：グループ売上高 300億円以上の達成（品質インフラとしての覇権確立）
「Laser Bond Tester (LBT)」を、世界の半導体・電子部品産業における「品質保証の必須インフラ（デファクトスタンダード）」として定着させる。

課題

- 1.供給責任の履行(生産能力):**世界的な品質危機（チャイナリスク等）を受け急増する需要に対し、現在の生産体制では供給が追いつかず、サプライチェーンのボトルネックとなっている。
- 2.国際標準化への壁:**日本発の独自技術を「国際規格(IEC)」へと昇華させるための、政治的・技術的リソースの不足。
- 3.市場のパラダイムシフト:**従来の「破壊検査」から「非破壊全数検査」への転換を促すための、啓蒙と実績作り。

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

コンソーシアム総力戦: 竹代リソース（ISO/UL準拠）と製造連携パートナーと共に2028年までに年間150台規模の量産体制を確立。機会損失をなくし、半導体供給網を強化化する。
ルールメイキング戦略: JEITAおよびIECを通じ、「【nonTAP法】」の国際標準化（2026-27年目途）を推進。技術の公共性を高め、市場全体への普及を加速させる。
応用分野の拡大: AI半導体（インターポーザ）に加え、車載用バッテリー、医療機器分野へ横展開し、複数の事業の柱を構築する。

実施体制

LBT事業(頭脳): コア技術【nonTAP法】開発、知財戦略、国際規格化推進、グローバルマーケティング。
竹代 事業(身体・幹事): コアユニット量産製造、サプライチェーン構築、資金管理、国内営業支援。
連携パートナー: 国内外のトップティア企業（自動車・半導体）及び有力商社と連携し、販売・保守網を構築。

